

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公表番号】特表 2003-532791 (P2003-532791A)
 【公表日】平成 15 年 11 月 5 日 (2003.11.5)
 【出願番号】特願 2000-502233 (P2000-502233)
 【国際特許分類第 7 版】

C 2 3 C 14/34
 B 2 1 J 5/00
 C 2 2 C 27/02
 // H 0 1 L 21/203

【F I】

C 2 3 C 14/34 A
 B 2 1 J 5/00 E
 C 2 2 C 27/02 1 0 3
 H 0 1 L 21/203 S

【手続補正書】
 【提出日】平成 15 年 5 月 27 日 (2003.5.27)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

多結晶性金属スパッタリングターゲットであって、4 % を超えない表面状態の配向性コン
tent 比の分散率を有していることを特徴とするスパッタリングターゲット。

【請求項 2】

多結晶性金属スパッタリングターゲットであって、平均粒子サイズで 3 % を超えない分散
率と、配向性 content 比で 4 % を超えない分散率とを有していることを特徴とするスパ
ッタリングターゲット。

【請求項 3】

6 μ m の平均粒子サイズを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッ
タリングターゲット。

【請求項 4】

Al、Ti、Ta、Cu、Nb、Ni、Mo、Au、Ag、Re 及び Pt から選択される
物質を含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングター
ゲット。

【請求項 5】

アルミニウムを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングタ
ーゲット。

【請求項 6】

チタニウムを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングター
ゲット。

【請求項 7】

タンタラムを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングター
ゲット。

【請求項 8】

銅を含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項 9】

ニッケルを含んでいることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項 10】

精微な冶金構造と表面状態とを備えた金属物体を製造する方法であって、

金属ビレットを提供するステップと、

該金属ビレットをその金属の再結晶温度以下である鍛造温度にまで加熱するステップと、

鍛造処理中に摩擦を減少させるため、前記金属ビレットを鍛造する鍛造機械のプレスプレ

ートと、鍛造される該金属ビレットの両端との間に固形潤滑剤を提供するステップと、

該金属ビレットを 70 % から 90 % の減厚率で望むビレット厚に鍛造するステップと、

鍛造された該金属ビレットを室温にまで冷却させるステップと、

略均質なストレイン分布状態とすべく 1 回毎に厚みを減少させるように該金属ビレットを
圧延してプレートとするステップと、

該プレートを再結晶アニール処理するステップと、

を含んで構成されていることを特徴とする製造方法。